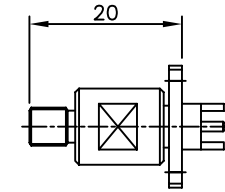


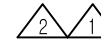
REVISION		
REV	DESCRIPTION	DATE
IR	최초 개정	2009. 01. 19.
1	[설번No.201810-0003] 원기철감 및 MATING 개선으로 인한 링 식재	2018. 10. 10.
2	[설번No.202006-0005] 메이팅 표준화로 인한 링 재추가	2020. 06. 17.

TM00089-7/1 + CN01078-7/1



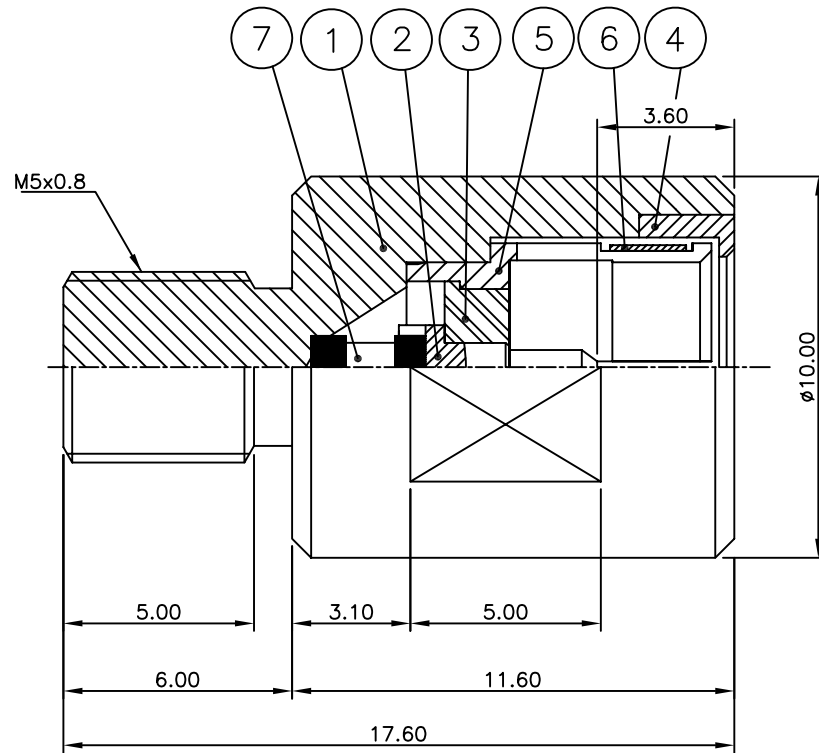
ELECTRICAL DATA

1	IMPEDANCE	50Ω Nominal
2	FREQUENCY	DC ~ 4GHz
3	V.S.W.R	1.2 : 1 (MAX)
4	RATING POWER	1 Watt



7	RESISTOR	1			DRE00057-N/1 (XA118)
6	SPRING RING	1	BeCu	Nickel Plate	DSR00007-5/1 (R2004)
5	JACK	1	MBsBD	Nickel Plate	DJA00119-5/1
4	COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DCO00080-5/1
3	INSULATOR	1	TEFLON	White	DIN01213-N/1 (H2391)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT01869-5/1
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD02334-5/1
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal	DATE 2020. 06. 17.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
	Angle	APPROVED BY	I.C.KIM	
MATERIAL	-	CHECKED BY		KJ COMTECH CO.,LTD. TITLE SMA trans(φ5.5)-P-TERM
		DRAWN BY	S.Y.EUN	
FINISH	-	SCALE	5/1	A4 DWG NO. TM00089-7/1 REVISION 2 SHEET 1 of 1
		UNIT	mm	



* 조립 주기

1. 품번5번 JACK에 품번6번 SPRING RING 조립한다.
2. 품번5번 JACK 품번 3번 INSULATOR를 조립한다.
3. 2번 CONTACT 와 7번 RESISTOR를 조립한다.
4. 위 2번 사항과 3번 사항을 조립한다.
5. 위 조립된 제품에 품번 1번 BODY에 조립 후 품번 4번 COVER를 조립 한다.
6. 멀티 미터기로 순수 저항 값을 확인 한다.
(47~53 Ω)